



中華民國專利證書

發明第 I 869154 號

發明名稱：先進半導體封裝結構

專利權人：慧隆科技股份有限公司

發明人：蔡憲聰、施養明、許宏源

專利權期間：自2025年1月1日至2044年1月4日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國 114 年 1 月 1 日

